

PR33825

☆共 JBN 外 0 2 6 0 (産業、半導体) (09・3・10)

【産業担当デスク殿】 3 3 8 2 5

◎WLCSP技術論文を発表へ カリフォルニア・マイクロ

【スコッツデール (米アリゾナ州) 10日 PRN=共同 JBN】カリフォルニア・マイクロ・デバイス (ナスダック: CMD) は10日、米アリゾナ州スコッツデールのラディソン・フォート・マクダウエル・リゾート&カジノで3月10日から12日まで開かれる実装技術関連の国際会議である IMAPS (インターナショナル・マイクロエレクトロニクス・アンド・パッケージング・ソサイエティー) のデバイス・パッケージングに関する第5回年次国際会議・展示会で、広域WLCSP (ウエハーレベル・チップスケールパッケージ) アレイの熱信頼性性能に関する技術論文を提出する。この発表はウエハーレベルのチップスケールパッケージボードの信頼性に関するWLCSPフォーラムが主催する技術的追跡論文の一環である。

▽WLCSP熱信頼性分析

「広域WLCSPアレイの熱信頼性性能」と題したこの論文は、広域かつ最新の10x10WLCSPアレイの熱信頼性性能に応えるものである。同論文はカリフォルニア・マイクロ・デバイスのファウンドリー・エンジニアリング・アンド・オペレーション担当ディレクターであるウメシュ・シャルマ博士、ハリー・ギー、フィル・ホーランド、ラム・スワミ各氏が執筆したもので、3月11日 (水曜日) 午後3時半にシャルマ博士から発表される。論文は会議後、同社ウェブサイト (www.cmd.com/applications/papers.php) あるいはウエハーレベル・チップスケール・フォーラムのサイト (www.wlcsforum.org) からダウンロードすることができる。

▽カリフォルニア・マイクロ・デバイスについて

同社は携帯機器、デジタル・コンシューマー・エレクトロニクス、パソコン各市場向けの特定用途アナログおよびミックスドシグナル半導体製品の有力サプライヤーである。主要製品は、携帯機器向け保護デバイスとデジタルTV、パソコンや携帯機器ディスプレイ用アナログおよびミックスドシグナルICなどのデジタル・コンシューマー・エレクトロニクス製品が含まれる。同社と製品の詳しい情報はウェブサイト (<http://www.cmd.com>) まで。

CMDロゴはカリフォルニア・マイクロ・デバイスの商標。その他の商標はそれぞれの所有者の資産である。

(了)

▽問い合わせ先

Kyle Baker of California Micro Devices Corporation,
+1-408-934-3117,
kyleb@cmd.com